

Title (en)

Fuse with high density ceramic casing and method of fabrication of that fuse.

Title (de)

Sicherung mit Umhüllung aus fester Keramik hoher Dichte und Herstellungsverfahren dieser Sicherung.

Title (fr)

Fusible à enveloppe de céramique rigide haute densité et méthode de fabrication de ce fusible.

Publication

**EP 0283414 A2 19880921 (FR)**

Application

**EP 88420094 A 19880321**

Priority

- CA 532649 A 19870320
- IN 226DE1988 A 19880321

Abstract (en)

[origin: US4855705A] A high power current-limiting fuse comprises a cylindrical envelope which closely surrounds a metallic fusible element in the form of a wire or ribbon. The cylindrical envelope is made of high density rigid ceramic such as Alumina of formula Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, and Beryllium oxide of formula BeO. The two ends of the envelope are metallized to form two terminals respectively connected to the ends of the fusible element, whereby the current-limiting fuse is connectable to an electric circuit to be protected through the two so formed terminals. A sheath of fiberglass or ceramic can be mounted around the cylindrical envelope so as to increase the mechanical rigidity of the current-limiting fuse.

Abstract (fr)

Ce fusible limiteur de courant (F) haute puissance comporte une enveloppe cylindrique (3) qui entoure de façon serrée un élément fusible métallique (1) sous forme de fil ou de ruban. L'enveloppe cylindrique (3) est fabriquée en une céramique rigide haute densité telle que l'alumine AL<sub>2</sub>O<sub>3</sub> et l'oxyde de Beryllium, BeO. Les deux extrémités de l'enveloppe (3) sont métallisées pour former deux terminaux (5,6) reliés respectivement aux extrémités de l'élément fusible (1), de manière à permettre la connexion du fusible limiteur de courant (F) à un circuit électrique à protéger. Une gaine (1) de fibre de verre ou encore de céramique peut être disposée autour de l'enveloppe cylindrique (3) pour ainsi augmenter la rigidité mécanique du fusible (F) limiteur de courant.

IPC 1-7

**H01H 85/18; H01H 69/02**

IPC 8 full level

**H01H 85/06** (2006.01); **H01H 37/76** (2006.01); **H01H 69/02** (2006.01); **H01H 85/02** (2006.01); **H01H 85/04** (2006.01); **H01H 85/045** (2006.01); **H01H 85/08** (2006.01); **H01H 85/10** (2006.01); **H01H 85/143** (2006.01); **H01H 85/165** (2006.01); **H01H 85/17** (2006.01); **H01H 85/18** (2006.01); **H01H 85/38** (2006.01)

CPC (source: EP KR US)

**H01H 69/02** (2013.01 - EP KR US); **H01H 85/165** (2013.01 - EP US); **Y10T 29/49087** (2015.01 - EP US); **Y10T 29/49107** (2015.01 - EP US); **Y10T 29/49155** (2015.01 - EP US)

Cited by

US11227737B2

Designated contracting state (EPC)

DE FR GB IT

DOCDB simple family (publication)

**EP 0283414 A2 19880921; EP 0283414 A3 19890222; EP 0283414 B1 19920923;** AR 241557 A1 19920831; BR 8801241 A 19881025; CA 1264791 A 19900123; CN 1008673 B 19900704; CN 1013719 B 19910828; CN 1042027 A 19900509; CN 88102153 A 19881005; DE 3874782 D1 19921029; DE 3874782 T2 19930401; IN 172362 B 19930703; JP S63264845 A 19881101; KR 880011853 A 19881031; KR 910005072 B1 19910722; MX 169655 B 19930716; US 4855705 A 19890808; US 4890380 A 19900102

DOCDB simple family (application)

**EP 88420094 A 19880321;** AR 31034788 A 19880318; BR 8801241 A 19880318; CA 532649 A 19870320; CN 88102153 A 19880319; CN 89107550 A 19880319; DE 3874782 T 19880321; IN 226DE1988 A 19880321; JP 6594788 A 19880322; KR 880002922 A 19880319; MX 1082188 A 19880318; US 27046588 A 19881109; US 27047888 A 19881109